

# 덕산하이메탈 (077360)

반도체/장비



**백길현 USCPA**

02 3770 5635  
gilhyun.baik@yuantakorea.com



**이재윤**

02 3770 5727  
jaeyun.lee@yuantakorea.com

투자의견	<b>BUY (I)</b>
목표주가	<b>27,000원 (I)</b>
현재주가 (1/11)	<b>19,000원</b>
상승여력	<b>42%</b>

시가총액	4,317억원
총발행주식수	22,718,501주
60일 평균 거래대금	51억원
60일 평균 거래량	304,219주
52주 고	20,550원
52주 저	11,400원
외인지분율	4.40%
주요주주	이준호 외 13 인 58.00%

주가수익률(%)	1개월	3개월	12개월
절대	8.6	50.8	52.0
상대	13.2	48.2	53.1

**실적예측** (억원, %)

	4Q21E	전년동기대비	전분기대비	컨센서스	컨센서스대비
매출액	330	121.3	35.7	303	8.9
영업이익	28	15.2	25.5	42	-32.9
세전계속사업이익	72	59.7	-11.0	136	-47.4
지배순이익	55	449.9	-25.4	124	-55.4
영업이익률 (%)	8.5	-7.9 %pt	-0.7 %pt	13.9	-5.4 %pt
지배순이익률 (%)	16.7	+10.0 %pt	-13.7 %pt	40.9	-24.2 %pt

자료: 유안타증권

## 2022년부터 시작되는 중장기 성장 스토리

### 투자의견 BUY, 목표주가 2.7만원으로 커버리지 개시

SOTP Valuation에 기반한 동사 기업가치는 6,100억원(본업 3,300억원 + 덕산넵코스 300억원 + 덕산네오룩스 지분가치 2,500억원)으로 추산.

본업 사업가치에는 PCB 소재사업과 미안마법인의 2022~2023년 평균 실적 반영. 국내외 PCB 업종 호황에 따른 성장, 특히 MSB(Micro Solder Ball) 침투율 가속화에 따른 수혜가 동사에 집중됨에 따라 2022~2023년 성장에 대한 실적 가시성이 높다는 판단.

### 22년, 23년 사상 최대 실적 기록할 전망

동사의 2022년 연결기준 예상 매출액과 영업이익은 각각 1,602억원(YoY 67%), 188억원(OPM 12%, YoY 129%)으로 추정. 2023년에도 실적 고성장 추세가 지속되면서 연결기준 매출액과 영업이익이 각각 1,927억원(YoY 20%), 317억원(YoY 68%, OPM16%)에 달할 전망.

2022년/2023년 본사기준 영업이익은 각각 151억원(OPM 18%, YoY 122%)/265억원(OPM 24%, YoY 75%)을 기록할 것. 고마진 제품인 MSB(Micro Solder Ball)와 P&F(Paste and Flux)가 이익 성장을 견인할 것으로 전망.

1)고부가 Flip Chip 계열 중심의 PCB 시장 확대가 MSB 시장 성장 견인, 2)여전히 주요 PCB 소재들의 일본 의존도가 높은 편이며 동사는 지난해 Paste & Flux 국산화에도 성공. 3)한편 올해부터 정상궤도에 진입할 것으로 전망되는 미안마법인(지분율 100%)은 주석 등 비철금속 제련 사업을 영위하고 있으며 향후 본업인 Solder ball 원가 절감에도 기여할 것.

### Solder Ball 시장의 중장기 성장 모멘텀

**첫째, Solder Ball 시장 침투율 가속화 → Solder Ball 매출 성장 근거:** 글로벌 PCB 시장 내에서 Flip Chip 패키지 기판 중심의 성장이 지속되는 가운데, Flip Chip 패키지 기판의 필수 소재인 Solder Ball 수요 또한 가파른 증가 예상.

최근 글로벌 주요 반도체 패키지 기판 업체들의 대규모 Capa 확장에 따른 Solder ball 증가분은 2022년~2023년부터 본격적으로 반영될 것. 한편, 현재 글로벌 PCB 시장 내에서 Wire Bonding과 Flip Chip 기판 비율은 각각 74%, 26%인 것으로 파악되는데, 향후 Flip Chip 기판의 시장 침투율은 2025년 30%, 2030년 45%로 확대되고 Wire Bonding 시장을 빠르게 대체해 나갈 것으로 전망.

**둘째, 특히 MSB(Micro Solder Ball)의 고성장에 대한 수혜 집중:** MSB가 Solder Paste를 대체하기 시작하면서 MSB 시장이 확대되고 있는 가운데, 동사는 글로벌 MSB 시장내 점유율이 60~70%에 달할 만큼 독보적인 입지를 확보하고 있다는 점에 주목.

**Forecasts and valuations (K-IFRS 연결)** (억원, 원, %, 배)

결산 (12월)	2019A	2020A	2021F	2022F
매출액	518	552	957	1,602
영업이익	41	64	82	188
지배순이익	112	153	240	317
PER	11.5	10.9	19.5	13.6
PBR	0.6	0.7	1.7	1.5
EV/EBITDA	13.9	15.2	37.0	18.7
ROE	5.7	7.3	10.2	12.0

자료: 유안타증권

## 1. Valuation

덕산하이메탈(077360) 대한 투자의견 BUY, 목표주가 2.7만원으로 커버리지를 개시한다.

목표주가는 SOTP(Sum of The Parts) 방식으로 산출했다. 목표주가 2.7만원에 해당하는 적정 시가총액은 6,100억원이다.

- 덕산하이메탈(본업) 사업가치는 3,300억원으로 2022~2023년 예상 순이익 \* 글로벌 PCB 업종 PER Multiple을 15배를 적용했다. 참고로 솔더블을 포함한 본업 실적에 미얀마 법인 실적을 합산하여 적용했다. 국내외 PCB 업종 호황에 따른 솔더블 성장과 더불어 MSB(Micro Solder Ball) 침투율 가속화에 따른 수혜가 동사에 집중됨에 따라 2022~2023년 성장에 대한 실적 가시성이 높다고 판단하기 때문이다.
- 덕산넵코어스(연결자회사) 사업가치는 장부가 300억원을 반영했다. 참고로 1) 2021년 3월 넵코어스(주) 인수 대금으로 370억원을 지불했다는 점, 2) 방위산업 성장에 따른 2022년 덕산넵코어스 매출액이 400억원을 웃돌 것으로 예상된다는 점을 반영하면 합리적이라는 판단이다.
- 덕산네오룩스(213420 KQ, 지분율 38%)에 대한 지분 가치는 2,500억원으로, 현재 덕산네오룩스 시가총액 1.3조원(1월 11일 종가 기준)에 대한 덕산하이메탈 지분율 38% \* 할인율 50%를 적용하여 산출했다.

## 2. 실적 추정

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
연결 매출	451	478	518	552	957	1,602	1,927
YoY%	-	6%	8%	7%	73%	67%	20%
본업	451	478	518	552	670	857	1,117
SB	334	325	343	327	383	447	553
MSB	61	62	91	142	175	224	320
P&F	-	-	-	8	45	105	148
기타	55	90	84	83	111	186	244
넵코어스	-	-	-	-	253	420	445
미얀마	-	-	-	-	35	325	325
연결 영업이익	27	12	41	64	82	188	317
본업	27	12	41	64	68	151	265
넵코어스	-	-	-	-	14	29	34
미얀마	-	-	-	-	-	9	18
연결 OPM%	6%	2%	8%	12%	9%	12%	16%
본업 OPM%	6%	2%	8%	12%	10%	18%	24%
넵코어스 OPM%	-	-	-	-	6%	7%	8%
미얀마 OPM%	-	-	-	-	0%	3%	6%

자료: 유안타증권 리서치센터

	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22
연결 매출	138	125	140	149	140	245	243	330	345	365	430	462
YoY%	13%	-4%	3%	16%	1%	96%	73%	121%	147%	49%	77%	40%
QoQ%	8%	-10%	12%	6%	-6%	75%	-1%	36%	5%	6%	18%	7%
본업	138	125	140	149	140	149	176	205	180	205	225	247
넵코어스	-	-	-	-	-	96	67	90	95	80	120	125
미얀마	-	-	-	-	-	-	-	35	70	80	85	90
연결 영업이익	19	(6)	26	24	14	18	22	28	33	43	57	56
OPM%	14%	-5%	19%	16%	10%	7%	9%	9%	10%	12%	13%	12%
YoY%	643%	적전	5%	792%	-28%	흑전	-15%	15%	139%	138%	152%	100%
QoQ%	597%	적전	흑전	-7%	-44%	29%	26%	26%	17%	29%	33%	0%
본업	19	(6)	26	24	14	12	20	23	27	37	43	44
넵코어스	0	0	0	0	0	6	2	6	6	6	10	8
미얀마	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5

자료: 유안타증권 리서치센터

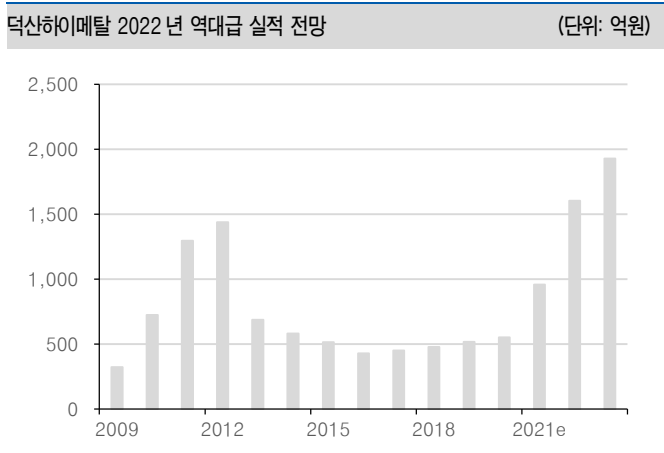
### 3. 2022년 사상 최대 실적 기록 전망

동사 연결기준 2022년 예상 매출액과 영업이익은 각각 1,602억원(YoY 67%), 188억원(OPM 12%, 129%)으로 사상 최대 실적을 기록하고, 이러한 가파른 성장세는 2023년까지도 지속될 것으로 전망한다.

2022년 본업 예상 매출액과 영업이익은 각각 857억원(YoY 28%), 151억원(OPM 18%, YoY 122%)을 기록할 것으로 추정한다. 특히 올해 Micro Solder Ball과 Paste/Flux의 연매출 성장률은 각각 28%, 135%로 전년도에 이어 2023년까지도 고성장이 지속될 것으로 전망된다는 점이 긍정적이다. 이는 1) 고부가 Flip chip 계열 중심의 PCB 시장 성장과 MSB 침투율 증가에 따른 수혜가 동사에 집중되고, 2) 과거 일본 업체(ex. Senju Metal)가 독점하던 소재 국산화가 본격화 될 것으로 예상하며, 3) 원재료(주석) 가격 인상분에 대한 판가 전이로 수익성 확보가 가능하기 때문이다.

미안마법인은 2022년 하반기부터 이익 기여를 시작할 것으로 추정한다. 2019년도에 법인이 설립되었으나 그간 코로나 팬더믹으로 인해 접근이 제한적이라 생산 정상화가 어려웠던 것으로 파악된다. 그러나 2021년 4분기부터는 전반적으로 생산 안정화가 진행되기 시작했으며, 2022년에는 온기 매출이 반영될 것으로 기대한다. 현재는 제품 고도화도 함께 진행중이기 때문에 2023년부터는 전사 수익성 증대에도 기여할 것으로 기대한다.

덕산넵코어스의 2022년 예상 매출액과 영업이익은 각각 420억원(YoY 66%), 29억원(OPM 7%, YoY 103%)을 기록하며 견조한 성장세를 이어나갈 것으로 추정한다. 그간 방위 산업 위주의 제품 공급으로 성장성이 제한적이었던 것으로 파악되지만, 올해부터는 5G 장비에 들어가는 부품 공급을 시작할 것으로 전망하기 때문이다.



자료: 유안타증권 리서치센터, 주: 2021~2023년 연결기준 예상 매출액 추정치 반영



자료: Quantwise, 유안타증권 리서치센터

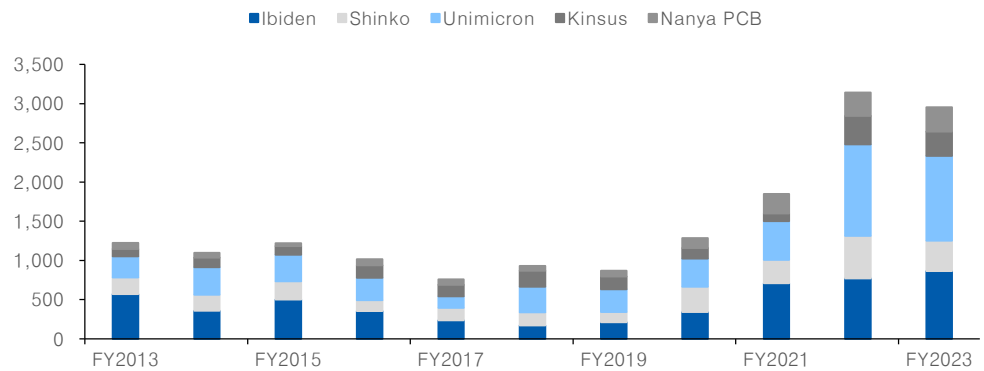
## 4. Solder Ball 시장의 증장기 성장 모멘텀

당사 리서치센터는 글로벌 Solder Ball 시장 성장 기울기가 가팔라 질 것으로 전망하는 가운데, 동사 2022~2023년 실적에 긍정적인 포인트는 크게 아래 2가지 이다.

**첫째, Solder Ball의 시장 침투율이 가속화되고 있다는 점을 주목한다.** PCB 기판 시장 내에서 Flip Chip 패키지 기판 중심의 성장이 지속되는 가운데, Flip Chip 패키지 기판의 필수 소재인 Solder Ball 수요가 가파르게 증가할 것으로 예상된다. 실제 2019~2021년 사이 집행된 글로벌 주요 반도체 패키지 기판 업체들의 Capa 확장에 따른 증분은 2022년 올해부터 본격적으로 반영될 것으로 전망된다. 한편 현재 글로벌 PCB 시장 내에서 Wire Bonding과 Flip Chip 기판 비율은 각각 74%, 26%인 것으로 파악되는데, 향후 Flip Chip 패키지 기판의 시장침투율은 2025년 30%, 2030년 45%로 확대되고 Wire Bonding 시장을 예상보다 빠르게 대체해 나갈 것으로 전망된다. 동사 Solder Ball 제품 외형 성장의 근거로 제시한다.

글로벌 해외 패키지 기판 공급사 Capex 변화 추이

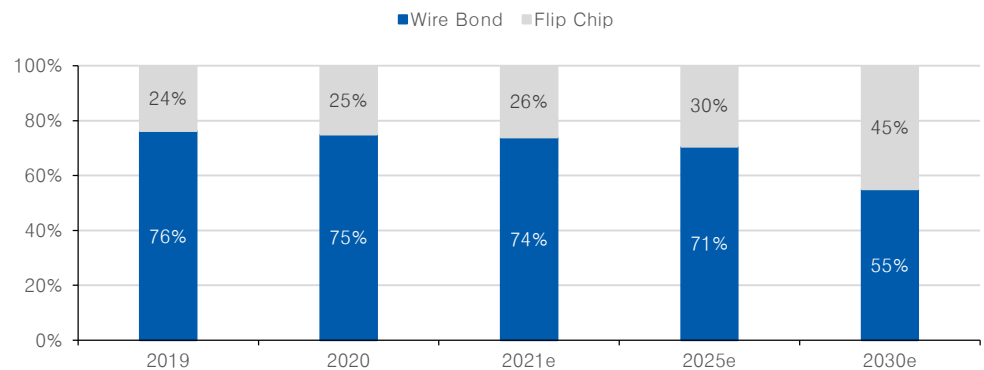
(단위: mn USD)



자료: Bloomberg, 유안타증권 리서치센터

Wire Bonding vs. Flip Chip 수요 비교

(단위: Bn Units)

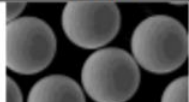
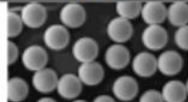
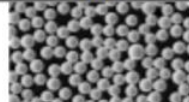


자료: 업계 자료, 유안타증권 리서치센터

둘째, MSB(Micro Solder Ball)의 고성장에 대한 수혜가 동사에 집중될 것으로 전망한다.

1) MSB(Micro Solder Ball) 적용처가 확대되고 있는 것으로 파악된다. 해당 제품은 과거 WLP(Wafer Level Package) 및 Embdedde Package 위주로 수요가 집중되어 있었지만, 최근에는 Flip Chip 계열 패키지 기판에도 사용되기 시작하면서 시장이 커지고 있다. 이에 더해 일부 Solder Paste 대신 Micro Solder Ball 적용도 진행되고 있는 것으로 파악된다는 점은 고성장 전망을 가능케한다.

Solder Ball 크기별 분류 - 50 마이크로 이하의 Solder Ball 은 Micro Solder Ball 로 분류

구분	크기(μm)	공차(μm)	진구도(%)
마이크로 솔더볼	50 ~ 99	±3	≤ 1.5
	100 ~ 249	±3	
무연 솔더볼	250 ~ 274	±4	
	274 ~ 299	±5	
	300 ~ 319	±8	
	320 ~ 499	±10	
	> 500	±15	
구분	150 μm	100 μm	50 μm
솔더볼 이미지			

자료: 업계 자료, 유안타증권 리서치센터

2) 동사는 MSB 시장내 70% 내외의 독보적인 입지를 확보하고 있다. 글로벌 Solder Ball 시장 내 점유율은 40% 수준이지만, MSB 시장을 선점하며 현재 글로벌 MSB 점유율은 70%를 육박하는 것으로 파악된다. 고객사의 Needs에 부합하는 제품을 적기에 공급한다는 경쟁력을 기반으로 글로벌 시장 내 70개 이상의 고객을 확보하고 있다. 실제 아래 PCB 공급사 외에도 글로벌 OSAT 및 반도체 Chipset 업체까지 고객군으로 두고 있기 때문에 MSB 고성장에 따른 수혜가 동사에 집중될 것으로 기대한다.

덕산하이메탈 PCB 업종 고객사



자료: 덕산하이메탈, 유안타증권 리서치센터

## 5. Appendix: 덕산하이메탈 개요

덕산하이메탈 주요 History

일자	내용
1999. 05	덕산하이메탈(주) 설립
1999. 07	DSHM 및 DSHM Aurora Solder Balls 상표출원
1999. 11	삼성전자 반도체, 하이닉스 반도체 협력업체 등록 양산 공급
2004. 06	덕산하이메탈 신축 공장 완공 / 이전 (울산광역시 북구 연암동 597-3)
2005. 10	KOSDAQ 상장
2006. 07	유미코아(벨기에) 투자조인식 체결
2009. 08	(주)루디스 흡수합병: 화학소재사업부 신설
2014. 12	화학소재 사업부(덕산네오룩스) 인적분할
2015. 09	지주회사 전환(공정거래위원회)
2016. 07	나노코리아2016 산업부문 장관상(산업통상자원부장관)
2016. 12	벤처활성화 유공포상(대통령상)
2018. 11	지주회사 적용제외(공정거래위원회)
2019. 06	해외 현지법인 DS MYANMAR CO LTD. 설립
2021. 03	덕산넵코어스(주) 지분 59.97% 취득

자료: Dart, 유안타증권 리서치센터

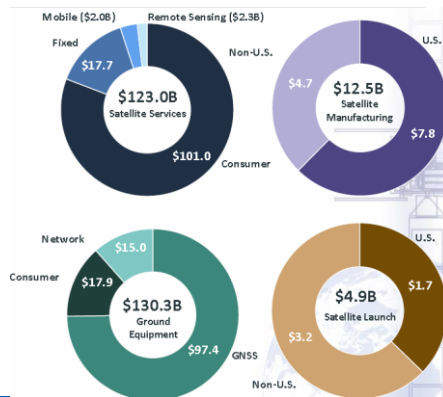
- 덕산 미얀마법인은 동사가 지분을 100% 자회사로, 원재료(주석, Solder Ball과 Paste의 원재료)의 비철금속 제련 사업을 담당하고 있음. 2021년 4분기부터 매출이 발생하고 있는 것으로 파악되며, 2022년 하반기부터는 전사 영업이익 기여가 가능할 것으로 추정.
- 덕산하이메탈은 2021년 3월 사업 다각화 목적으로 방위산업 전문기업 넵코어스 지분 60% 인수. 넵코어스는 (구)한양네비콤의 방위사업부문과 연구개발진을 인수하면서 설립된 회사로 과거에는 개인용 정보 단말기(PDA, Personal Digital Assistant) 안에 들어가는 GPS 수신기를 납품. 현재는 GPS 기술을 원천으로 한 Location & Timing 솔루션을 납품하고 있음. 추가적으로 2022년부터는 해외 5G 기지국 관련 신제품이 추가되면서 외형 성장이 가능할 것으로 전망.
- 덕산네오룩스(213420 KQ)는 동사의 자회사로 덕산하이메탈 산하에 있던 화학 소재 사업부를 2014년에 인적분할하여 코스닥 시장에 상장. 당시 덕산네오룩스에 대한 지분율은 15% 수준이었으나, 현재는 38%(2021년도 3분기말 기준) 수준인 것으로 파악됨.

덕산넵코어스 전방시장 구분 1



자료: 업계자료, 유안타증권 리서치센터, 주: 덕산넵코어스는 Ground Equipment 시장 내에서 Consumer Equipment 로 분류 가능

덕산넵코어스 전방시장 구분 2



자료: 업계자료, 유안타증권 리서치센터, 주: 덕산넵코어스는 Ground Equipment 시장 내에서 Consumer Equipment 로 분류 가능

국내 우주항공 관련 업체

	국내	해외
위성체, 발사체 제작	썬트렉아이, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 한국항공우주, LIG 넥스원, AP 위성 등 25개사	Lockheed martin, Airbus, Mitsubishi, ISRO, TAI 등
지상장비	인텔리안테크, 썬트렉아이, 한양이엔지, 제노코, 하이룩코리아, 한국조선해양, 넵코어스 등 18개사	Telespazio Spa, RUAG, Panasonic 등
위성서비스	한화시스템, STX 엔진, 케이티셋, 대성티엠씨, 넵코어스, 솔탐, 비엔티, 이엔지정보기술 등	이리디움, 오르비콤, 레오셋, 플래닛, EU 텔셋, 아마존, 스페이스X 등

자료: 유안타증권 리서치센터



덕신하이메탈 (077360) 추정재무제표 (K-IFRS 연결)

손익계산서 (단위: 억원)					
결산 (12월)	2019A	2020A	2021F	2022F	2023F
매출액	518	552	957	1,602	1,927
매출원가	405	357	707	1,190	1,380
매출총이익	113	195	250	412	547
판매비	72	132	168	223	230
영업이익	41	64	82	188	317
EBITDA	64	89	128	237	383
영업외손익	82	150	196	223	255
외환관련손익	5	-15	-3	16	16
이자손익	10	4	-1	-2	-1
관계기업관련손익	71	106	181	210	240
기타	-4	55	19	0	0
법인세비용차감전순손익	123	213	278	412	572
법인세비용	10	61	36	91	126
계속사업순손익	112	153	242	321	446
중단사업순손익	0	0	0	0	0
당기순이익	112	153	242	321	446
지배지분순이익	112	153	240	317	441
포괄순이익	106	152	194	270	395
지배지분포괄이익	106	152	192	266	389

주: 영업이익 산출 기준은 기존 k-GAAP과 동일. 즉, 매출액에서 매출원가와 판매비만 차감

현금흐름표 (단위: 억원)					
결산 (12월)	2019A	2020A	2021F	2022F	2023F
영업활동 현금흐름	73	78	-142	-120	93
당기순이익	112	153	242	321	446
감가상각비	23	25	43	47	64
외환손익	7	13	11	-16	-16
중속, 관계기업관련손익	-71	-106	-181	-210	-240
자산부채의 증감	-24	-50	-266	-273	-171
기타현금흐름	24	44	8	10	9
투자활동 현금흐름	-81	-147	-328	-79	-42
투자자산	11	-22	-323	0	0
유형자산 증가 (CAPEX)	-85	-96	-161	-120	-80
유형자산 감소	2	3	90	0	0
기타현금흐름	-9	-33	65	41	38
재무활동 현금흐름	-1	-2	301	-17	-17
단기차입금	0	0	165	0	0
사채 및 장기차입금	0	0	-3	-2	-2
자본	0	0	0	0	0
현금배당	0	0	0	0	0
기타현금흐름	-1	-2	139	-15	-15
연결범위변동 등 기타	-6	-12	22	217	237
현금의 증감	-15	-82	-147	0	272
기초 현금	406	391	309	162	162
기말 현금	391	309	162	162	434
NOPLAT	41	64	82	188	317
FCF	-12	-18	-303	-240	13

자료: 유안타증권

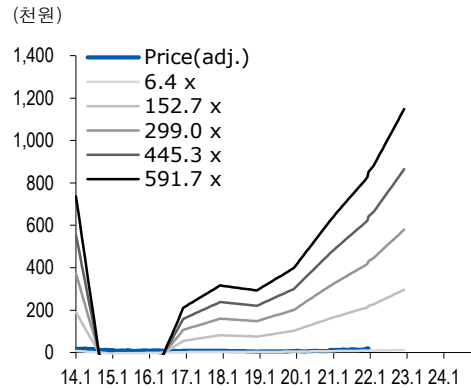
- 1. EPS, BPS 및 PER, PBR은 지배주주 기준임
- 2. PER 등 valuation 지표의 경우, 확정치는 연평균 증가 기준, 전망치는 현재주가 기준임
- 3. ROE, ROA의 경우, 자본, 자산 항목은 연초, 연말 평균을 기준으로 함

재무상태표 (단위: 억원)					
결산 (12월)	2019A	2020A	2021F	2022F	2023F
유동자산	582	562	757	996	1,397
현금및현금성자산	391	309	162	162	434
매출채권 및 기타채권	97	129	190	254	292
재고자산	83	92	321	496	586
비유동자산	1,519	1,738	2,297	2,369	2,384
유형자산	282	356	501	574	590
관계기업등 지분관련자산	1,115	1,233	1,370	1,370	1,370
기타투자자산	42	65	72	72	72
자산총계	2,102	2,300	3,054	3,365	3,781
유동부채	83	92	328	345	354
매입채무 및 기타채무	31	63	114	131	140
단기차입금	16	15	200	200	200
유동성장기부채	0	0	3	3	3
비유동부채	19	59	141	139	137
장기차입금	0	0	9	8	6
사채	0	0	0	0	0
부채총계	102	151	469	484	492
지배지분	2,023	2,172	2,516	2,781	3,171
자본금	45	45	45	45	45
자본잉여금	1,085	1,085	1,080	1,080	1,080
이익잉여금	1,942	2,097	2,337	2,654	3,095
비지배지분	-23	-23	70	100	118
자본총계	2,000	2,149	2,586	2,881	3,289
순차입금	-372	-291	9	7	-267
총차입금	20	18	215	214	212

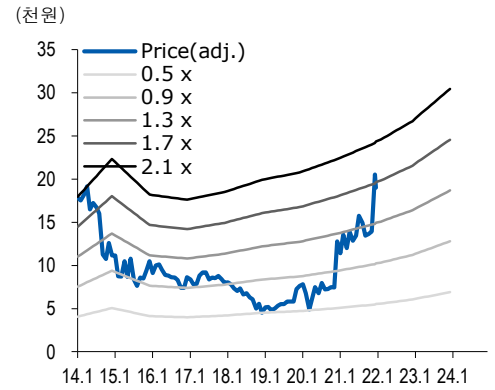
Valuation 지표 (단위: 원, 배, %)					
결산 (12월)	2019A	2020A	2021F	2022F	2023F
EPS	495	672	1,056	1,396	1,940
BPS	10,136	10,885	11,789	13,034	14,859
EBITDAPS	283	391	565	1,042	1,685
SPS	2,278	2,431	4,214	7,051	8,482
DPS	0	0	0	0	0
PER	11.5	10.9	19.5	13.6	9.8
PBR	0.6	0.7	1.7	1.5	1.3
EV/EBITDA	13.9	15.2	37.0	18.7	10.9
PSR	2.5	3.0	4.9	2.7	2.2

재무비율 (단위: 배, %)					
결산 (12월)	2019A	2020A	2021F	2022F	2023F
매출액 증가율 (%)	8.4	6.7	73.3	67.3	20.3
영업이익 증가율 (%)	250.2	56.6	29.0	129.2	68.3
지배순이익 증가율 (%)	-7.5	35.9	57.1	32.2	38.9
매출총이익률 (%)	21.7	35.4	26.2	25.7	28.4
영업이익률 (%)	7.9	11.5	8.6	11.8	16.5
지배순이익률 (%)	21.7	27.6	25.1	19.8	22.9
EBITDA 마진 (%)	12.4	16.1	13.4	14.8	19.9
ROIC	9.4	9.4	8.1	10.7	15.6
ROA	5.5	6.9	9.0	9.9	12.3
ROE	5.7	7.3	10.2	12.0	14.8
부채비율 (%)	5.1	7.0	18.1	16.8	15.0
순차입금/자기자본 (%)	-18.4	-13.4	0.4	0.2	-8.4
영업이익/금융비용 (배)	166.6	261.1	26.2	53.1	89.5

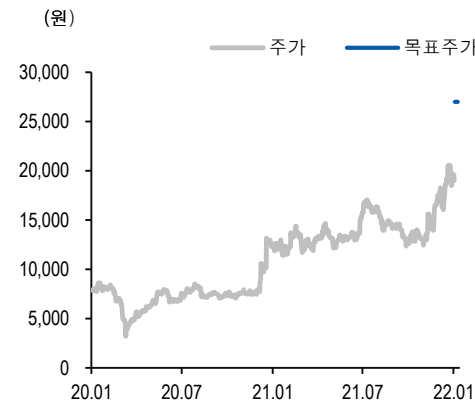
P/E band chart



P/B band chart



덕산하이메탈 (077360) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2022-01-12	BUY	27,000	1년		

자료: 유안타증권

주: 과리율 = (실제주가\* - 목표주가) / 목표주가 X 100

- \* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
- 2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0.0
Buy(매수)	93.3
Hold(중립)	6.7
Sell(비중 축소)	0.0
합계	100.0

주: 기준일 2022-01-09

※ 해외 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. (작성자: 백길현, 이재윤)
- 당사는 자료공표일 현재 동 종목 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 자료공표일 현재 해당 기업과 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다.
- 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료공표일 현재 대상법인의 주식관련 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 종목 투자등급 (Guide Line): 투자기간 12개월, 절대수익률 기준 투자등급 4단계(Strong Buy, Buy, Hold, Sell)로 구분한다
- Strong Buy: 30%이상 Buy: 10%이상, Hold: -10~10%, Sell: -10%이하로 구분
- 업종 투자등급 Guide Line: 투자기간 12개월, 시가총액 대비 업종 비중 기준의 투자등급 3단계(Overweight, Neutral, Underweight)로 구분
- 2014년 2월21일부터 당사 투자등급이 기존 3단계 + 2단계에서 4단계로 변경

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.